

STELIAU

TECHNOLOGY ●●●●

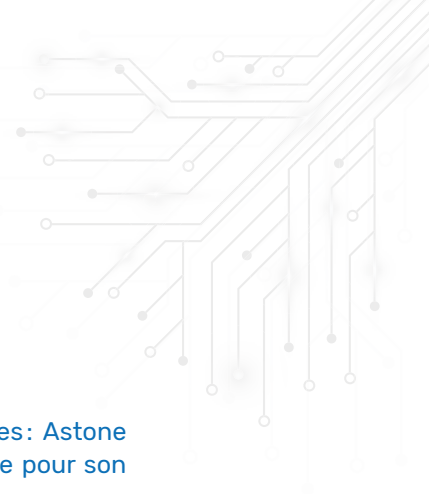


ASTONE
TECHNOLOGY



Astone Technology et Silfox deviennent Steliau Technology

www.steliau-technology.com



Steliau Technology regroupe deux entités expertes dans leurs domaines : Astone Technology, spécialisée en composants électroniques et Silfox, reconnue pour son expertise thermique, connectique et mécatronique.

Ce rapprochement, issu d'une volonté commune, celle de faire évoluer leurs offres en proposant des solutions complètes et personnalisées, permet la mise en commun de leurs produits, expertises et technologies, afin d'apporter aux clients des solutions complètes et efficaces.

La création de cette nouvelle société vise plusieurs objectifs :

- S'engager sur des solutions optimisées au travers d'intégrations technologiques
- Garantir aux clients un time-to-market toujours plus court
- Accroître la pertinence de son offre en augmentant son panel de technologies et de services
- Développer une expertise technique de haut niveau sur l'ensemble des technologies du groupe
- Renforcer ses partenariats exclusifs avec des fabricants leaders sur le marché
- Étendre sa présence à l'international par l'intermédiaire de son bureau à Shenzhen

Cette fusion fait de Steliau Technology l'un des acteurs incontournables dans les domaines de l'électronique, contribuant à déployer son savoir-faire en France et à l'étranger autour de trois mots-clés : service, expertise et innovation.

SOMMAIRE

Connectivité.....	4
Composants électroniques.....	9
Affichages et solutions tactiles.....	12
Systemes embarqués	18
Conversion d'énergie.....	21
Thermique	22
Nos services en thermique	23
Connectique	24
Audio/Vidéo.....	26
Mécanique.....	28
Steliau Technology.....	30

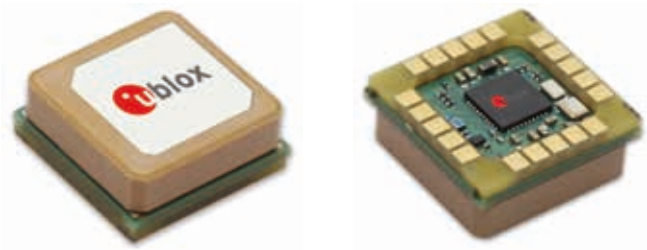
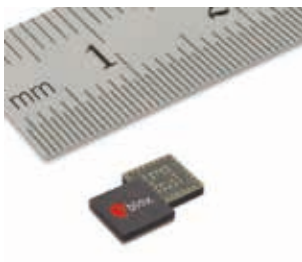




SOLUTIONS MULTI - GNSS

Modules Multi-Constellations GNSS GPS / GLONASS / GALILEO / BEIDOU / QZSS

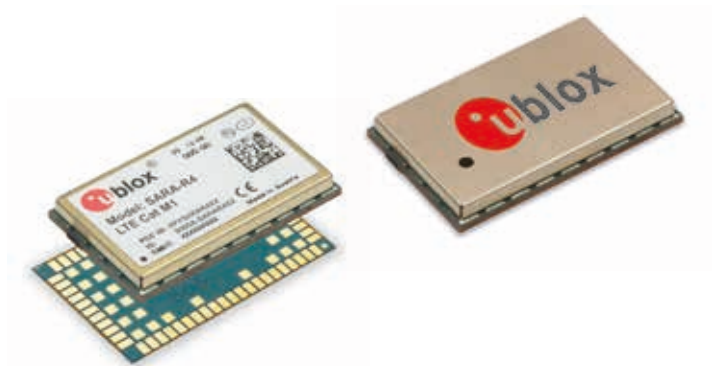
- Très haute sensibilité
- Faible consommation
- Antenne intégrée
- Ultra-miniature
- Ultra-hautes performances (Précision cm (RTK)/ Timing/Dead Reckoning)



MODULES CELLULAIRES

Modules cellulaires normés 3GPP

- 2G/3G
- 4G bas débit LTE Cat-1/LTE Cat-M1/NB-IoT pour les applications IoT
- 4G haut débit pour les routeurs et les applications automobiles



MODULES WI-FI / BLUETOOTH / BLE

- Modules Wi-Fi et/ou BT/BLE
- Modules «stand alone (AT)» ou «host based»
- Avec ou sans antenne
- Versions Open CPU (programmables)
- Versions multi-radio
- Versions pin à pin compatibles

Les produits Ublox sont conçus pour des applications industrielles dans l'IoT (buildings et environnements, industrie 4.0, sécurité, santé et médical)

SOLUTIONS CELLULAIRES



Routeurs et passerelles cellulaires sécurisés pour applications critiques

Large gamme de solutions M2M cellulaires 3G, 4G LTE et LTE-Advanced (LTE-A)

- Routeurs cellulaires et passerelles sécurisés pour applications industrielles.
- Connectivité robuste et fiable
- Transactions commerciales sécurisées pour les points de vente (POS) conformes à la norme PCI, le Fail Over
- Capture de données et gestion à distance



Les solutions cellulaires Digi transport

MODEMS CELLULAIRES EMBARQUÉS

Une manière simplifiée d'intégrer la connectivité cellulaire embarquée

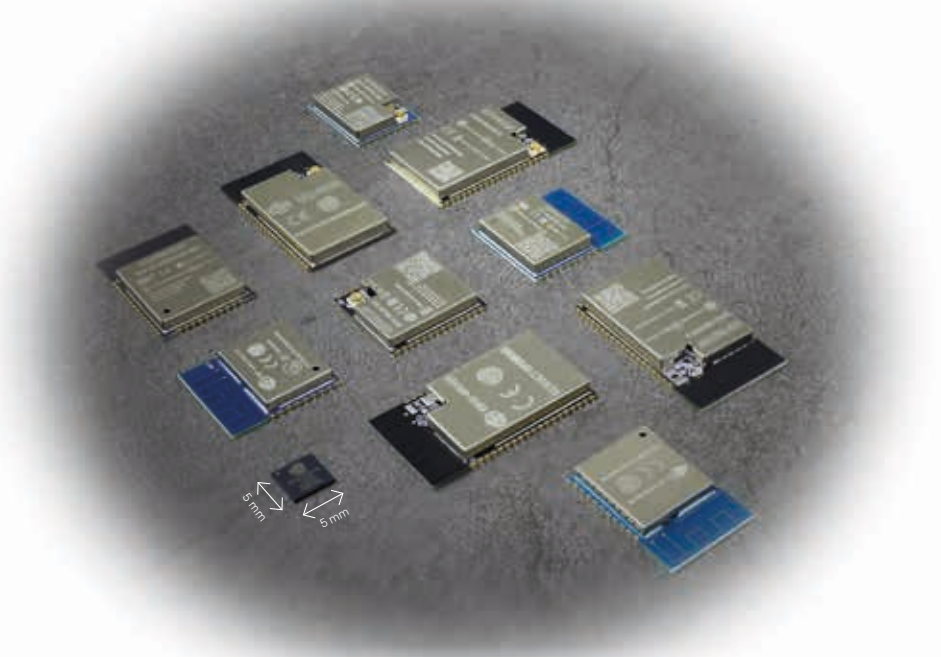
- Simple intégration de la connectivité cellulaire dans un appareil OEM
- Introduction des normes 3GPP (LTE Cat 1, LTE-M, NB-IoT) et des normes plus anciennes (3G HSPA/GSM)
- Simple connectivité cellulaire sans avoir à passer par un processus coûteux de certification



Les modems cellulaires XBEE

SOLUTIONS WI-FI / BT / BLE**Famille des ESP32 : Puces et modules Wi-Fi, Bluetooth Classique & Bluetooth Low Energy (BLE)**

- Processeur double cœur ultra performant (vitesse d'horloge jusqu'à 240 MHz)
- Connectivité Wi-Fi / BT / BLE (2.4Ghz)
- MESH BLE et Wi-Fi supporté
- Très faible consommation : 5 modes de faible puissance
- Mémoire flash : jusqu'à 128 Mbits + PSRAM de 32 Mbits
- Très haut niveau d'intégration (moins de 10 composants externes)
- Ultra haute sécurité (encryption flash & secure boot)
- Certification globale (CE, FCC...) & engagement de pérennité de 12 ans
- Fonctionne avec les plateformes IoT Amazon Alexa, Google Assistant et Microsoft Azure

**SOLUTIONS WI-FI****Famille des ESP8266 : Puces et modules Wi-Fi seuls**

- Processeur 32 bits ultra performant & intégré
- Connectivité Wi-Fi Radio (2.4Ghz) + MESH Wi-Fi supporté
- Faible consommation : 80mA en moyenne
- Très haut niveau d'intégration (moins de 10 composants externes)
- Mémoire flash : Jusqu'à 128 Mbits de flash
- Certification globale (CE, FCC...) & engagement de pérennité de 12 ans

Les produits Espressif sont conçus pour des applications grands publics dans l'IoT (buildings et environnements, industrie 4.0, sécurité)





SOLUTIONS LPWAN SIGFOX

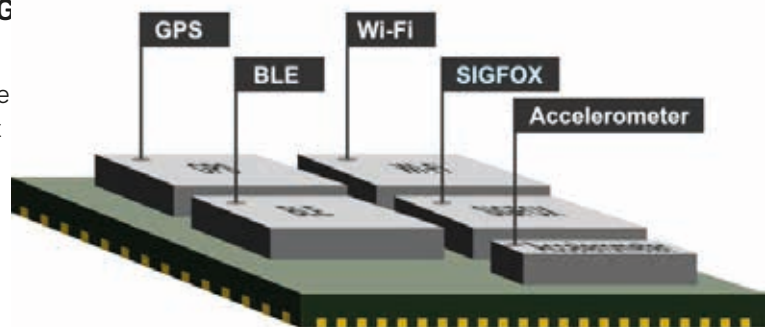
Modules Sigfox only

Ces modules vous permettront d'intégrer et d'utiliser le réseau Sigfox LPWAN dans votre conception de projet IoT, offrant une fonctionnalité de transmission de données très simple et valable pour l'ensemble des régions du monde (RCZ1/2/3/4).



Modules Sigfox Quad-mode : Wi-Fi / G BLE / Accéléromètre

Ils sont certifiés Sigfox Quad-mode pour l'ensemble des régions du monde (RCZ1/2/3/4) intégrant un CPU ARM Cortex M4F



Caractéristiques principales des modules Wisol

- Module certifié Sigfox Verified
- Empreintes ultra-petites
- Versions pin à pin compatibles pour toutes les régions
- Contrôle simple par commandes AT
- Certification : CE, FCC, TELEC, ANATEL
- Consommation de courant très faible pour une durée de vie prolongée de la batterie
- Niveau de puissance Tx contrôlable pour une optimisation complète (pour RCZ1 et RCZ3)
- Températures de fonctionnement : -30°C à +85°C
- Host CPU
 - ARM Cortex M4F
 - 512kB Flash / 64kB RAM



COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES



SPI NOR FLASH

Haute performance et sécurité

- Disponible en 1.8V, 2.5V, 3.0V
- Fonctionne en mode SPI simple, double et quadruple
- Transfert de données Quad-SPI pouvant aller jusqu'à 532 Mbits
- Mémoire flexible (taille du secteur : 4K octets, taille du bloc : 32/64K octets)
- Disponible dans une plage de température de -40 à +85°C



SPI NAND FLASH

Stockage haute capacité

- Disponible en 1.8V et 3.0V
- Fréquence haute vitesse (120MHz pour lecture rapide avec charge 30pF)
- Transfert de données Quad I/O pouvant aller jusqu'à 480Mbit/s
- Fonctions NAND avancées y compris ECC interne
- Disponible dans une plage de température de -40 à +85°C



CONDENSATEURS

- Aluminium E-cap
- Green-Cap (Electric Double Layer Capacitors)
- MLCC
- DCC
- Haute tension
- Basse tension



COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES



ACCESSOIRES

- Entretoises & colonnettes



- Accessoires de câblage



- Rivets & fixations

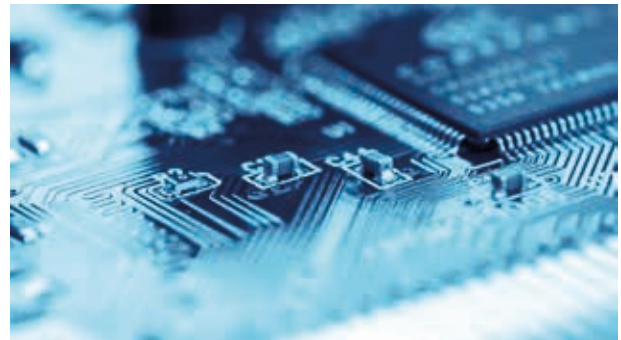


- Pieds adhésifs



ACCESSOIRES

- Alumines
- Isolants électriques
- Canons isolants
- Tubes isolateurs



MODULES DE CONVERSION D'ÉNERGIE ET D'ALIMENTATION

- Modules DC/DC
- Modules AC/DC
- Eclairages LED
- Modules d'alimentation
- Gestion de batteries
- Module de rétroéclairage
- Amplificateurs audios Class-D
- Fusibles et commutateurs de charge
- Commandes de moteurs
- Capteurs de position
- Solutions analogiques de précision



ANTENNES

- Antennes Actives Multifonctions (GNSS)



- Antennes externes (GPS / GSM / FM)



- Antennes monopuces



- WPC (recharge sans fil par induction)



- Antennes dipôles

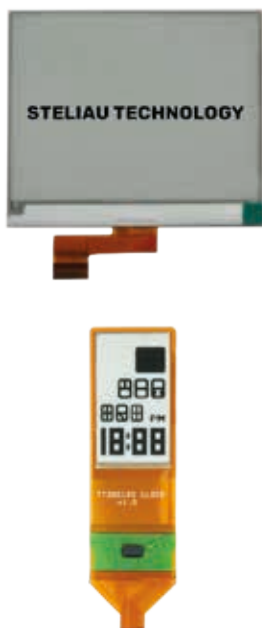


- Antennes lecteurs NFC
- Antennes bluetooth & NFC



AFFICHAGE ET SOLUTIONS TACTILES

SOLUTIONS FAIBLE CONSOMMATION



SOLUTIONS E-PAPER

Principales caractéristiques de la technologie E-ink :

- Aucune énergie consommée pour lire l'information affichée (zéro power)
- Utilise la lumière ambiante comme source d'éclairage (réflectif)
- Possibilité d'ajouter un front light
- Contraste élevé, très bonne lisibilité
- Très faible épaisseur permettant d'optimiser l'intégration mécanique
- Très larges angles de vue (180H X 180V)
- Solution customisée en segments
- Module standard en résolution graphique :
Possibilité d'afficher en noir et blanc ou noir et blanc + rouge
1"54; 2"13 ; 2,7";2,9"; 4,2"; 6";7,5"; 9,6"; 13,3"; 32"

MODULES INDUSTRIELS SUR LA BASE D'UN 32" ET 13"3 EINK

Modules 32" pour des marchés « intérieurs »

- Existe en monochrome noir et blanc
- IP 66 et IK07 garantissant étanchéité et résistance aux chocs
- Intègre une glace de protection en verre de 2 mm et permet une utilisation avec des températures de fonctionnement de l'ordre de 0 à 50°C.

Modules pour applications « extérieures »

- Intègre une glace de protection de 5 mm répondant aux normes IK07.
- Ce module permet de travailler avec des températures de fonctionnement de 0°C à 70°C en mode niveaux de gris.
- Possibilité de fonctionnement en température -20°C à +70°C en mode monochrome noir et blanc.
- Facilité de fixation grâce à des fixations au standard VESA.
- Visible en plein soleil
- Jusqu'à 20 jours de fonctionnement sur batterie disponible en option
- Une fois l'image chargée, plus besoin d'alimentation/zéro power
- Chargement du contenu via Bluetooth, Wi-Fi ou 4G à partir d'un smartphone





SOLUTIONS OLED

- Haute luminosité, faible consommation
- Larges angles de vue (175H x 175 V)
- Température étendue entre - 40°C et + 80°C
- Durée de vie de 60 000h (en jaune)
- Possibilité de custom (segments)



SOLUTIONS LCD MONOCHROME

- Technologie VA (Vertical Alignment)
- Excellent contraste > 1000 :1
- Angles de vue très ouverts
- Fonction tactile par zone optionnelle (jusqu'à 12")

SOLUTIONS INTERFACES HOMME-MACHINE (IHM)

- Etanchéité IP, températures étendues
- Solutions standards et customisées



AFFICHAGE ET SOLUTIONS TACTILES

ÉCRANS TFT

Stelium Technology propose une large gamme d'écrans TFT pouvant couvrir une grande variété d'applications comme les transports (trains, bus avions, etc.), les équipements médicaux, les distributeurs automatiques, les kiosks de vente de tickets, l'agriculture, la marine, le PID et bien d'autres encore.



GAMME INDUSTRIELLE

Nos différents partenaires permettent de couvrir les dimensions suivantes en gamme industrielle :

- Format standard de 1"4 à 19"
- Format wide de 4"3 à 32"
- Format stretch de 19"2 à 37"

En fonction des écrans nous pouvons fournir des solutions :

- En gamme de températures étendues : -40°C/+85°C
- Rétroéclairage LED jusqu'à 100 000 heures
- Tenue aux vibrations supérieures à 6.8 G
- Luminosité jusqu'à 2 500 Cd/m²
- Grande pérennité des produits

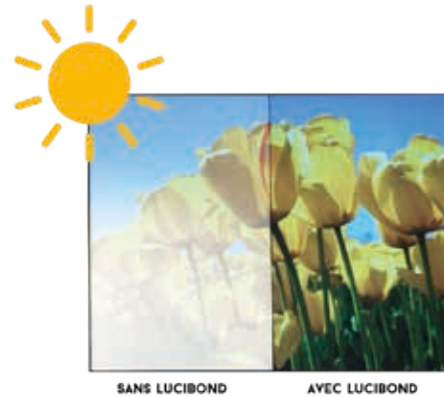
GAMME PID

Que ce soit pour des applications d'information voyageur, de PLV, de kiosks ou autres, Stelium Technology offre de multiples solutions.

- Format 21"5 à 100"
- Format stretch 19"2 à 37"
- Format ultra stretch 23"1 (1920X158)
- Solution en 4K et 8K
- Possibilité d'écran en High Tni (110°C en surface de verre) et Luminosité 2 500 Cd/m² pour les applications extérieures.
- Ecrans transparents
- Mode paysage et portrait, 24/7



SOLUTIONS TACTILES ET OPTICAL BONDING



PCAP (CAPACITIF PROJETÉ)

- 3,5" à 100" : solution de vitre de protection antivandalisme, tous traitements de surface : antireflet, anti-trace de doigt, effet déperlant, antibactérien, anti-rayure et bien d'autres encore
- Solutions spécifiques outdoor (pas de yellowish, ni de blackening): insensibilité matérielle au rayonnement solaire
- Forte résistance à la contrainte CEM, en rayonné jusqu'à 30V/mètre et en conduit jusqu'à 10 Vrms
- Fonctionnement en présence d'eau y compris le ruissellement, avec des gants de forte épaisseur, support stylet EETI
- Intégration de tous types de filtre: restriction d'angle de vue, film MESH, revêtement ITO, bus bar Silver et Copper etc.
- Développement custom selon besoin client spécifique, gestion d'interface RIU (RS232, I2C, USB)
- Maîtrise de la chaîne complète des outils de fine-tuning (EETI) pour l'optimisation du fonctionnement de la dalle dans l'écosystème de l'applicatif client
- Support sur tout OS, pré-qualification CEM des firmwares
- Famille EETI 80H80 et 80H100: nouvelle génération de contrôleurs PCAP utilisant simultanément les deux modes de détection: SELF et MUTUAL capacitance

RÉSISTIFS

- 4 et 5 fils avec option True Flat
- Version extrême +85°C en opération pour environnements très difficiles
- Technologie spécifique de forte tension du film pour éviter l'écrasement des spacers (grade automobile)

CADRE INFRAROUGE TOUTE TAILLE

Gamme de cadres infrarouges (IR) de 10,4" à 103" répondant aux contraintes industrielles

- Simplement le PCB
- Le PCB encapsulé dans un cadre en métal
- La solution complète avec une vitre de protection disponible en différentes épaisseurs

Stelium Technology fournit également le support pour l'intégration software de la solution de contrôleur.

En support direct avec la maison mère, Stelium Technology représente officiellement et de manière exclusive la marque EETI sur le marché Français.



TouchKit



AFFICHAGE ET SOLUTIONS TACTILES

NOS SERVICES D'INTÉGRATION POUR DALLES TACTILES ET ÉCRANS

INTÉGRATION DE DALLES TACTILES

- Intégration de dalles tactiles (toutes technologies) en air gap dans notre salle blanche certifiée ISO6 (classe 1000)
- Intégration de dalles tactiles (toutes technologies) par bonding. Différents types de bondings : OCA, OCR, LucidBond. Permet l'amélioration de la visibilité de l'écran (luminosité, angle de vue, contraste, indice de réflexion < 1%) pour un confort visuel en environnement fortement lumineux. Protection de l'écran aux UV. Amélioration de la résistance aux chocs.
- Réalisation de moniteurs spécifiques avec nos dalles PCAP
- Développement de bezel plastique à la demande autour du PCAP



*Salle blanche Stelieu Technology,
Fresnes*

INTÉGRATION ÉCRANS

- Réalisation de câbles LVDS et backlight sur mesure
- Réalisation d'OpenFrame
- Intégration mécanique
- Cartes d'interface A/D (entrée VGA, DVI, HDMI, DP) pour écrans TFT



CLAVIERS ET SOUS-ENSEMBLES

PRINTEC



CLAVIERS À MEMBRANES

- Touche d'activation extra plate ou embossée
- Avec clavier silicone moulé possible
- Avec dômes polyesters ou à coupelles métalliques.
- Avec LEDS intégrées
- Avec zones électroluminescentes
- Le circuit est réalisé sur feuille de polyester, kapton, FPC
- Sérigraphie ou impression digitale
- Waterproof

CLAVIERS SUR P.C.B/FR4

- Le circuit est réalisé sur P.C.B/FR4
- Assemblage possible avec clavier silicone
- Avec LEDS intégrées
- Avec zones électroluminescentes
- Connectique de liaison

CLAVIERS POUR APPLICATIONS MÉDICALES

- Pour les interfaces médicales
- Façade anti-bactéries
- Avec LEDS intégrées
- Avec zones électroluminescentes
- Connectique de liaison
- PRINTEC - Certification médicale 13485-1

SOUS-ENSEMBLES COMPLETS



- Intégration avec injection plastique
- Intégration avec tôle de télécommande spécifiques complètes
- Intégration avec écran tactile (touchscreen)



PROCÉDURES DE TEST ET CONTRÔLE

Certifications :

- ISO9001
- ISO14001
- ASUS GREEN
- ISO 14485-1
- ISO 13485-2

SYSTÈMES EMBARQUÉS

CARTES PC INDUSTRIELS

- Format de modules ADD-ON de type SOM ou All-IN-One de type SBC
- Standard Pico-ITX à Micro-ATX & eNuc
- Température commerciale et industrielle



BOITIERS PC INDUSTRIELS

- Boitier Standard ou Fanless du processeur baytrail au core i7 7^e génération
- Modèles dédiés par marché pour applications transport, médical, POS/POI, marine
- Température commerciale et industrielle

IHM / PANEL PC / MONITEURS INDUSTRIELS

- IHM & Panel PC 7 à 32 pouces, ARM ou x86/64, tactile ou non tactile
- Résistif, PCAP. Moniteurs. Montage avant ou arrière
- Modèles dédiés par marché pour applications **transport, médical, industrielles, digital signage**
- Cartes d'interfaces et solutions customs



CARTES ET SYSTÈMES EMBARQUÉS

- Format SOM ou SBC
- Standard Micro Q7, Q7, SMARC, COM Express ou SBC iMX6 Solo
- DUAL LITE, DUAL, QUAD ; iMX7, iMX8
- Température commerciale et industrielle
- Cartes Industrielles Udoor Néo sur-ensemble Raspberry iMX6Solo Arduino



SOLUTIONS DE STOCKAGE

- Mémoire DDR, SD et Micro SD
- SSD 2.5", M-SATA, M.2, SATA DOM
- Technologie Flash MLC, pSLC & SLC



SYSTEM ON MODULES

Solutions system-on-modules ultra compactes et hautement intégrées

- Solutions sans fil intégrées, y compris 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
- Options pour ajouter des fonctions cellulaires
- Conçues sur les derniers processeurs, tels que le NXP i. MX6UL et le NXP i. MX6
- Sécurité des périphériques pour les applications connectées IoT
- Développement accéléré avec les environnements de développement embarqués Android et Linux, y compris « Yocto Project ».

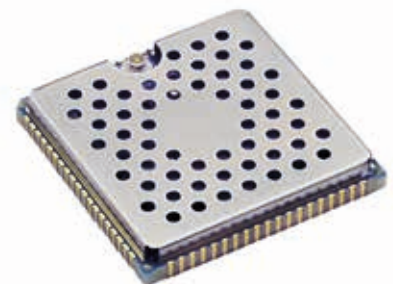


ConnectCore 6

- Solution ultra compacte et hautement intégrée basée sur la famille de processeurs NXP/Freescale i. MX6 Cortex-A9.
- Vitesses de processeur allant jusqu' à 1,2 GHz et des variantes mono/double/quad-cœur entièrement compatibles
- Solution de plateforme évolutive avec des performances sans fil pré-certifiées (802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, BLE)
- Conception à faible encombrement et au montage en surface optimisant la flexibilité d'intégration
- Réduction considérable des risques de conception : facteur de forme fiable avec des capacités de dissipation thermique optimisées (même dans les configurations quadruple-cœur les plus exigeantes)
- L'intégration Cloud intégrée à la plateforme logicielle Digi Linux et Android offre des fonctionnalités de gestion à distance sécurisée et de services Web grâce au Digi Device Cloud évolutif.

ConnectCore 6 UL

- Plateforme system-on-modules connectée, sécurisée et flexible, légèrement plus grande qu'un timbre-poste.
- Intégration simplifiée pour la conception : technologie SMT, facile à utiliser ou option LGA pour une flexibilité d'intégration avec accès à toutes les interfaces.
- Elaboration sur le processeur d'application NXP i. MX6UL ultralite.
- Moteur de communication le plus intelligent pour les périphériques connectés sécurisés d'aujourd'hui.
- Intégration transparente le Wi-Fi dual Ethernet et pré-certifié double bande (802.11a/b/g/n/AC) avec la connectivité Bluetooth 4.2.



La sécurité des périphériques embarqués est un aspect essentiel de la conception pour le nombre croissant d'applications connectées («IoT») et le ConnectCore 6UL supprime les obstacles à l'implémentation en vous fournissant Digi TrustFence, une plate-forme de modules sécurisés entièrement intégrée au système d'exploitation Linux Yocto.



NOS SERVICES D'INTÉGRATION PC INDUSTRIELS

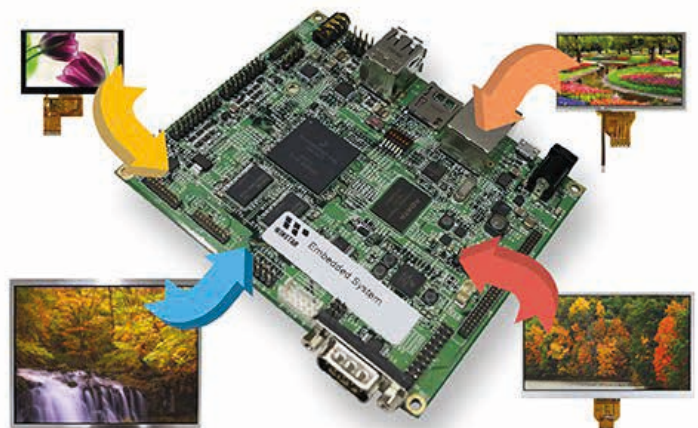
- Constitution d'un dossier d'intégration pour votre projet série.
- Intégration des sous-ensembles pour votre projet dans le système (processeur, mémoire, SSD, cartes).
- Mise à jour des Firmwares.
- Chargement du système d'exploitation (Windows, Linux, Android).
- Chargement du logiciel applicatif.
- Tests de série.
- Conditionnement standard ou spécifique du produit.



KIT CARTES ET TABLETTES DURCIES

KIT CARTES

- Fourniture de kits prêt à intégrer
- Kits composés :
 - D'une carte mère ARM NXP Cortex – A9 Dual Core 1.0Ghz, 2GB DDR3 & 8GB eMMC Nand flash
 - D'un module TFT de 5"-12.1"
- Interface RGB & LVDS
- Plage de température pouvant aller de -10°C à +60°C
- Support Android



TABLETTES DURCIES

- Tablettes industrielles et durcies de 7 pouces à 13,3 pouces : options GPS, 3G/4G, Wi-Fi/BT
- Lecteur de cartes, code-barres, empreintes, NFC, Windows/Ubuntu/Android
- Nombreux accessoires de montage



CONVERSION D'ÉNERGIE



ALIMENTATION AC/DC

- DIN-Rail
- Panel Mount
- Open Frame
- Adaptateurs
- Modules d'alimentation pour PCB
- Drivers de LED



CONVERTISSEURS AC/DC

- Modules de 4W à 60W
- Modules PACSR de 300 & 500W
- Modules FACSR de 800W



CONVERTISSEURS DC/DC

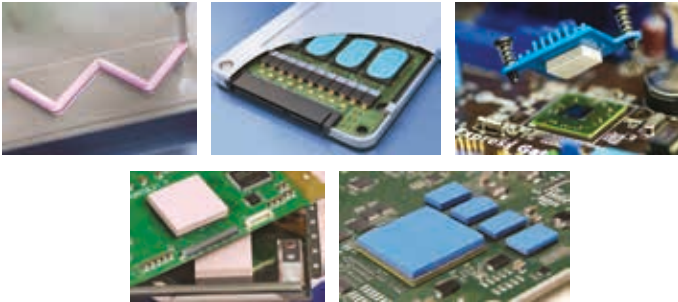
- DC/DC isolé open frame
- DC/DC isolé boitiers encapsulés
- DC/DC isolé type box
- DC/DC non isolé type POL

MODULES FILTRES

- **Filtre EMI 1"x1"**
THT encapsulé
Courant : 5A max
VIN (Volt In Put) : 75 V max
FL75 L5A
- **Filtre EMI 1"x1"**
Open Frame SMD/THT
Courant : 7A max
VIN : 75 V max
FL75L7 A / FL75L7 B
- **Filtre EMI 2"x1"**
THT encapsulé
Courant : 10A max
VIN : 75 V max
FL75L10 A
- **Filtre EMI 2"x1,6"**
THT encapsulé
Courant : 20A max
VIN : 75V max
FL75L10 A / FL75L10 B



BERGQUIST



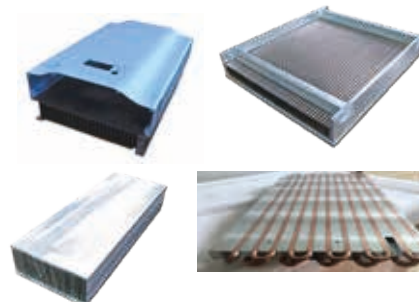
INTERFACES THERMIQUES

- Sil Pad®, Film isolant thermique
- Gap Pad®, Matelas thermique
- Gap Filler®, Liquide thermique
- Liqui Bond®, Colle thermique
- High Flow®, Changement de phase
- Bond Ply®, Adhésif thermique
- T-CLAD®, SMI

DISSIPATEURS

- Plaques froides, FSW et Brasées
- Dissipateurs, Standards ou sur plan
- Bonded Fin, Collés ou brasés
- Skived Fin, Taillés dans la base
- Zipper Fin, Pliés et brasés
- Stacked Fin, Pressés ensemble
- Caloducs, intégration heat pipe

wakefield-vette



VENTILATEURS



- Ventilateurs AC/DC/EC
- Ventilateurs centrifuges
- Version IP54 à IP68
- Smart Fan
- Double Fan
- Chipset cooler
- Rack de ventilation



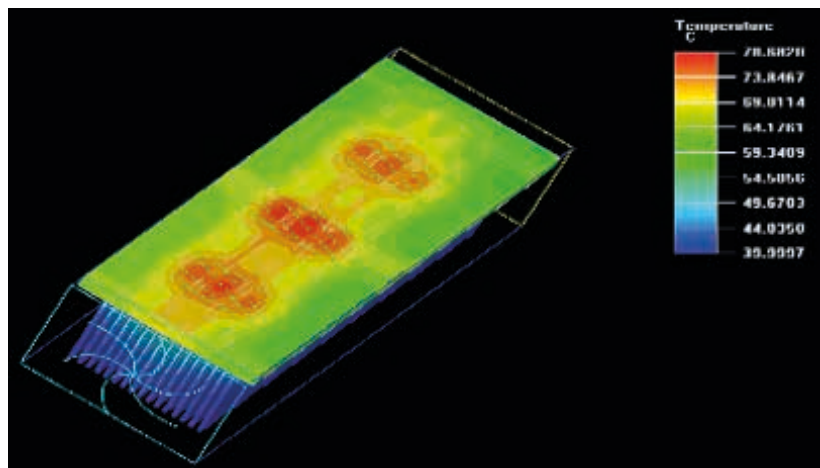
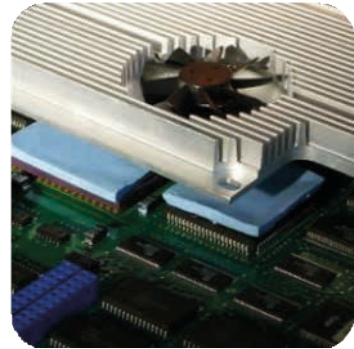
- Ventilateurs axiaux de 25 mm à 528 mm
- Turbines de 75 mm à 404 mm



NOS SERVICES EN THERMIQUE

ÉTUDE THERMIQUE

- Simulation
- Découpe sur mesure
- Design to cost



RÉALISATION DE KITS

- Prototypes délais court (48 heures)
- Design CAO



ASSEMBLAGE DE PIÈCES

- Pads thermiques
- Dissipateurs
- Joints & fixations
- Ventilateurs

LES CONNECTEURS



- Système d'interconnexion pour véhicule électrique et borne de charge
- Solution d'interconnexion pour télécommunication et transmission
- Solution d'interconnexion pour équipement électrique de puissance
- Solution d'interconnexion pour équipement médical
- Connectique circulaire
- Connectique rectangulaire
- Busbar
- Connectique Optique
- PDU
- Faisceaux



- Micro-Coax
- FPC/FFC
- Micro RF Coax



- Carte edge
- Haute température
- Test socket TO



- Carte à carte / Carte à nappe
- Base flottante
- Haute densité
- Fine pitch

INTERCONNEXIONS

- Carte à carte
- Carte à fils
- Carte à nappe
- Micro Match
- DIN41612
- FFC
- Support CI
- Pitch jusqu'à 0,5 mm



ENTRÉE-SORTIE

- USB - Mini - Micro - type 3
- RJ45 - bas profil-blindé - RJ11
- SUBD - micro D
- HDMI - DVI - Display port
- RF
- Mini PCI
- Jack

CABLES ET CORDONS

- Spécifique sur plan
- Surmoulé
- Etanche IP68
- Harnais
- Faisceaux
- Puissance
- HE10



SOCKETS POUR CARACTERISATION (ELECTRIQUE/MECA...)

- 100% customisable pour tous types de boîtiers électroniques (BGA / LGA / QFN / CQFP / PLCC...)
- Sockets spécifiques pour test PCB et FLEX FPC
- Matière haute température EGB-HT Epoxy noir (Tenue en température de fonctionnement : -55°C ; +150°C)
- Technologies appliquées (POGO PIN Hautes fréquences avec 10kcycles en durée de vie, élastomères 40Ghz...)
- Sélection sur des fermetures standardisées E-TEC (Fastlock / Quicklock / Clamshell / Open Clamshell...)
- et des formes de pogos (CONVEXE / CONCAVE / CROWN...)
- Adaptation sur interface client PCB existant
- Applications spécifiques : Tests hautes fréquences / EMI / Irradiations...



SOCKETS POUR FIABILITE (HTOL/BURN-IN...)

- Supports semi-injectés avec possibilité de customiser la fermeture pour tous types de boîtiers électroniques (BGA / LGA / QFN / CQFP / PLCC/ TSOP / SOP...)
- Supports full injectés en open top compatibles avec tous types de boîtiers électroniques (BGA / LGA / QFN / CQFP / PLCC/ TSOP / SOP...)
- Réalisation de pogos spécifiques pour l'utilisation BURN-IN
- Pour pitch de 0,40 mm à 1,27 mm
- + de 25 000 cycles en ouverture /fermeture



Leader incontesté du déport de signaux vidéo

Déports de type DVI, HDMI, SDI, Display Port, USB et FireWire

- Fibre optique :
 - Mini modules ou boîtiers détachables
 - Type « AOC » (Active Optical Cable) combinant les qualités de la fibre (distance, qualité, immunité aux parasites...) avec celles des câbles traditionnels en cuivre (transport des données auxiliaires et de l'énergie), plus pratique et à moindre coût.
- Paires torsadées CAT 5/6 (en IP ou HDBaseT)
- Sans fils



Autres produits

Matrices, distributeurs, sélecteurs, convertisseurs et autres déports de type « KVM » (Keyboard, Video, Mouse)



Spécialiste du déport de signaux essentiellement de type USB et KVM

- Produit de qualité fiable et robuste
- Paires torsadées CAT 5e/6/7, parfois en IP, mais aussi sur fibre optique pour de plus grandes distances et l'immunité aux parasites



Nouvelle
gamme
Raven

Premiers et uniques déports de signaux USB de type 1.1, 2.0 et 3.1, à ce jour

- 100 mètres en paires torsadées CAT 6/7
- 200 mètres sur fibres multimode



L'un des plus importants fabricants de produits pour l'Audio/Vidéo Pro et Broadcast

- Gamme complète de produits innovants
- 7 ans de garantie sur la plupart des produits
- Technologies à base d'IP, dont le produit « phare » est le système de présentation de type collaboratif « VIA »



Autres produits

Déports, systèmes de présentation, scaleurs, matrices, convertisseurs etc.



L'innovation jusque 12G-SDI...

- Gamme complète de convertisseurs, distributeurs et déports fibre, dont certains en châssis 2U 10 modules
- Déport SDI sur fibre jusqu' à 12G SDI
- Possibilité d'émettre sur fibre en HDMI et de recevoir directement en SDI et vice-versa

Autres produits

- Matrices multi-formats

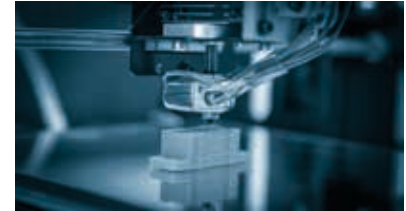
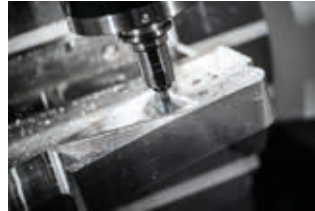


**Fonction générateur/analyseur/
cross-convertisseur/monitoring
et batterie en accessoire**

SRXTRONIC

PROTOTYPAGES

- Usinages CNC
- Impressions 3D
- Injections plastiques
 - Moule d'injection
 - Moulage par injection et surmoulage
 - Assemblage
- Moulages silicone



Les capacités de fabrication et les laboratoires de conception de pointe permettent aux équipes d'ingénierie de réaliser ces concepts rapides et efficaces et d'effectuer des essais et des validations pertinentes. Les capacités de prototypage rapide peuvent produire des prototypes sous 4/5 jours.

TÔLERIES FINES DE PRÉCISION

Une solution à valeur ajoutée unique pour les fabrications et les assemblages de tôles.

- Découpe laser à rotation rapide, poinçon NCT, pliage, soudage, finition de surface réversible, assemblage complexes



EMBOUTISSAGES DE PRÉCISION

L'emboutissage est un procédé industriel qui s'appuie sur des équipements équipés de matrices pour produire des formes à partir de tôle. Des solutions de poinçonnage de précision et de fabrication à valeur ajoutée avec un atelier d'outillage et de matrices complexes. Nous pouvons également nous occuper de vos besoins cosmétiques en utilisant des techniques de finition haut de gamme telles que le polissage, grain et traitement.

- Plaques perforées
- Pliages
- Enveloppes extérieures
- Progressif
- Perçages poinçonnages

USINAGES DE PRÉCISION

Les centres d'usinage CNC avancés permettent une flexibilité de fabrication et des réponses rapides pour la plupart des produits de précision et compliqués, de très petites à très grandes tailles.

- Décolletage
- Electroérosion
- Fraisage / Tournage 3/5 axes
- Rectifiage



FONDERIES ALUMINIUM

La coulée sous pression est un procédé de fabrication dans lequel le métal fondu est coulé dans des moules en acier. Les moules - aussi appelés outils ou matrices - sont réalisés en acier et sont spécialement conçus pour chaque produit. Cela permet de créer chaque composant avec précision et répétabilité. L'aluminium, le zinc et le magnésium sont les alliages de moulage sous pression les plus couramment utilisés.

- Alliage aluminium
- Extrusions aluminium
 - Outillage extrusion

DIE CUTTING

Votre partenaire manufacturier pour les joints d'étanchéité, les produits d'isolation, les produits de découpe et les produits de blindage EMI/RFI, desservant une variété de marchés.

SILICONE RUBBER

Des formulations de caoutchouc sur mesure et de larges capacités de production de moulage nous permettent d'offrir des solutions rentables pour les longs ou les courts tirages.

TRAITEMENTS DE SURFACE

La variété des traitements de surface permet d'améliorer la corrosion, la conduction, l'isolation, l'adaptation à l'environnement, ainsi que les visibilité cosmétiques.



UNE COUVERTURE D'OFFRE INÉGALÉE

- Augmentation de l'offre sur mesure
- Aide au design de projets (hard & soft), permettant une réduction du «time-to-market»
- Fine Tuning et customisation garantissant un rendu optimisé
- Conception et assemblage de sous-ensembles permettant la facilitation et la réduction des coûts d'approvisionnement
- Gestion de stock et d'approvisionnement, y compris en Asie, afin d'être toujours plus près de votre consommation

LES RESSOURCES STELIAU TECHNOLOGY

SUPPORT AVANT ET APRÈS VENTES

Une équipe d'ingénieurs commerciaux

- Des responsables produits pour chaque Business Units
- Des ingénieurs supports et des développeurs
- L'accès direct aux FAE des fabricants

Des équipements et une organisation de qualité

- Une salle blanche pour le montage des dalles tactiles
- 2 machines de découpe sur mesure consacrées aux pads thermiques
- Un laboratoire pour l'assemblage et la configuration d'écrans, de tablettes et de PC industriels
- Une ligne d'intégration de sous-ensembles
- Un atelier dédié au contrôle qualité et de traitement des RMA
- Plus de 1 500 m² d'espace de stockage

NOS BUREAUX EN FRANCE ET NOS ÉQUIPES EN ASIE



France ● Paris ● Angers ● Bordeaux ● Lyon ● Grenoble ● Nice
Chine ● Shenzhen **Taiwan** ● Taichung

📍 41-43, rue Périer, 92120 MONTRouGE

☎ Tél : +33 (0)1 55 58 04 04
☎ Fax : +33 (0)1 55 58 04 00

✉ contact@steliau-technology.com

🌐 www.steliau-technology.com